



平成 24 年 5 月 14 日

各 位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 権田 浩一
(JASDAQ・コード3374)
問合せ先 常務取締役 管理本部長 米澤 秀記
電 話 03-5433-1123 (代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 21 日開催予定の第 51 回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を下記の通り付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、定款の変更案は本日開催の取締役会で決議した内容ですが、平成 24 年 6 月 21 日開催予定の株主総会に上程する際には、文言の修正を行う場合があります。

記

1. 変更の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条(目的)について事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(目的)	(目的)
第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第 2 条 (条文現行どおり)
1. 下記商品に対する売買業及び輸出入業	1. (条文現行どおり)
① 空圧機器、同応用機器類、油圧機器、同応用機械類、工作機械、電気機器及びその他工具類	① (条文現行どおり)
② 鋼材、非鉄金属、金属製品	② (条文現行どおり)
③ 塗料、その他化学製品	③ (条文現行どおり)
④ 日用雑貨品	④ (条文現行どおり)
(新設)	⑤ <u>半導体製造装置及び一般産業機械に係る中古品</u>
(新設)	⑥ <u>医療機器</u>
2. (条文記載省略)	2. (条文現行どおり)
3. (条文記載省略)	3. (条文現行どおり)
4. 半導体製造装置の設計、製造、組立、検査、搬送、据付、調整及び保守	4. <u>半導体製造装置及び一般産業機械</u> の設計、製造、組立、検査、搬送、据付、調整及び保守
5. 半導体製造装置の設計、製造、組立、検査、搬送、据付、調整及び保守の請負	5. <u>半導体製造装置及び一般産業機械</u> の設計、製造、組立、検査、搬送、据付、調整及び保守の請負
6.～9. (条文記載省略)	6.～9. (条文現行どおり)

3. 日 程

- | | | |
|-----|----------------|------------|
| (1) | 取締役会決議日 | 平成24年5月14日 |
| (2) | 定時株主総会決議日 (予定) | 平成24年6月21日 |
| (3) | 定款変更効力発生日 (予定) | 平成24年6月21日 |

以 上